香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

ASMPT LIMITED

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：0522）

二零二五年第一季度業績新聞稿

有關 ASMPT Limited 及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止三個月業績的新聞稿附載於本公告。

承董事會命
董事
黃梓达

香港，二零二五年四月三十日

於本公告日期，本公司董事會成員包括獨立非執行董事：Orasa Livasiri 小姐（主席）、樂錦壯先生、黃漢儀先生、鄧冠雄先生、張仰學先生及蕭潔雲女士；非執行董事：Hichem M'Saad 博士及 Paulus Antonius Henricus Verhagen 先生；執行董事：黃梓达先生及 Guenter Walter Lauber 先生。

（本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。）

[新聞稿]

ASMPT 公布二零二五年第一季度業績

集團業績概覽

二零二五年第一季度概要

- **第一季度銷售收入達到預測的中位數**
- **新增訂單總額勝過預期**
- **毛利率回升至 40.9%**
- **高頻寬記憶體 TCB 支持客户的大批量生產**
- **擴大 TCB 客戶群**

業績摘要

- 銷售收入為港幣 31.2 億元(4.02 億美元)，按年-0.5%，按季亦-8.2%
- 新增訂單總額為港幣 33.5 億元(4.31 億美元)，按年+4.8%，按季亦+2.9%
- 毛利率為 40.9%，按年-97 點子，按季則+371 點子
- 經營利潤為港幣 1.60 億元，按年-33.3%，按季則+3,044.6%
- 盈利為港幣 8,260 萬元，按年-53.5%，按季則+1,853.5%
- 經調整盈利為港幣 8,320 萬元，按年-53.1%，按季則+1.6%
- 每股基本盈利為港幣 0.20 元，按年-53.5%，按季則+1,900.0%
- 經調整每股基本盈利為港幣 0.20 元，按年-53.5%，按季則持平

二零二五年第二季度銷售收入預測

- 將介乎 4.1 億美元至 4.7 億美元之間，以其中位數計按年+3.0%，按季亦+9.6%

詳盡業績公告及投資者簡報可見於
https://www.asmpt.com/en/investor-relations/financial-information/

有關上述經調整盈利及經調整每股基本盈利之詳情，請參閱集團二零二五年第一季度業績公告「香港財務報告準則計量對非香港財務報告準則計量之對賬」一節。

（二零二五年四月三十日，香港訊）— **ASMPT Limited**（「ASMPT」/「集團」/「公司」）（股份代號：0522），一間全球領先之半導體和電子產品製造的硬體和軟件解決方案供應商，公布集團截至二零二五年三月三十一日止三個月之第一季度業績。

集團行政總裁黃梓达先生表示：「在人工智能快速應用的推動下，我們的先進封裝解決方案不斷增長。集團於二零二五年第一季度表現穩健，毛利率提升至超過 40% 。我們擴大了熱壓焊接的客戶群，贏得了新訂單，而且我們的工具正用於邏輯和記憶體應用的生產，這進一步鞏固了我們在TCB市場的領導地位。展望未來，我們仍然對先進封裝以及於人工智能和高效能運算應用的 TCB 解決方案的需求充滿信心。」

集團二零二五年第一季度摘要

先進封裝（「AP」）解決方案繼續是採用人工智能的主要受惠者，在TCB工具的帶領下表現強勁。集團已完成一家領先記憶體客戶的批量熱壓焊接（「TCB」）訂單的付運，而這些主要用於12層HBM3E的解決方案支持客戶的大批量生產。集團亦獲得多位客戶更多的TCB訂單。就表面貼裝技術解決方案分部而言，其系統封裝（「SiP」）解決方案於本季度錄得季節性的強勁訂單。然而，集團的主流業務繼續受到來自汽車及工業終端市場需求疲軟的影響。

集團的毛利率重回超過 40%的水平，主要由於兩個分部均有更佳的產品組合。

- 銷售收入達港幣 31.2 億元（4.02 億美元），達到預測銷售收入的中位數，按季減少 8.2%，按年則持平。
- 新增訂單總額勝過預期達港幣 33.5 億元（4.31 億美元），按季增長 2.9%，按年亦增長 4.8%。按季增長主要來自表面貼裝技術解決方案分部新增訂單總額的增加，部分增長被半導體解決方案分部新增訂單總額從二零二四年第四季度的高基數減少所抵銷。按年增長則由半導體解決方案分部所推動，其季度新增訂單總額已在過去六個季度實現按年增長。
- 毛利率為 40.9%，按季上升 371 點子，按年則下降 97 點子。按季增長主要來自半導體解決方案及表面貼裝技術解決方案兩個分部。
- 受惠於嚴謹的成本控制措施及季節性因素，集團的營運開支(「Opex」)按季減少 11.3%。由於策略性基礎設施及研發的投資，營運開支按年則上升 4.1%。
- 經調整盈利為港幣 8,320 萬元，按季增長 1.6%，按年則減少 53.1%。按年下降是受毛利率輕微下降，策略性投資的營運開支及外幣匯兌的影響所致。

前景

集團有信心維持先進封裝解決方案的銷售收入，並預計其主流業務因季節性及勝過預期的第一季度新增訂單總額而將有所增長，集團預計二零二五年第二季度的銷售收入將介乎 4.1 億美元至 4.7 億美元之間, 以其中位數計按年上升 3.0%，按季亦上升 9.6%。

展望未來，鑒於關稅的間接影響的不確定性，集團主流業務的增長軌跡難以預測。然而，集團對先進封裝及其應用於人工智能和高性能計算的 TCB 解決方案的需求仍充滿信心。此外，集團的全球生產布局為其應對關稅的潛在影響提供了靈活性。集團將繼續密切監察有關情況，並根據需要進行調整。

關於 ASMPT Limited（「ASMPT」）

ASMPT是一間全球領先之半導體及電子產品製造硬體及軟件解決方案供應商。ASMPT總部位於新加坡，產品涵蓋半導體裝嵌和封裝及SMT(表面貼裝技術)，從晶圓沉積乃至於各種幫助組織、組裝及封裝精細電子組件的解決方案，以便客戶用於各種終端用戶設備，如電子產品、移動通訊器材、計算設備、汽車、工業以及LED(顯示板)。ASMPT與客戶緊密合作，持續投資於研究及發展，開拓具有成本效益和行業影響力的解決方案，為提升生產效率、提高產品的可靠性和質素貢獻力量。ASMPT也是半導體氣候聯盟的創始成員之一。

ASMPT在香港聯交所上市(香港聯交所股份代號: 0522)，並且是恒生科技指數、恒生綜合市值指數下之恒生綜合中型股指數、恒生綜合行業指數下之恒生綜合資訊科技業指數、恒生可持續發展企業基準指數及恒生香港35指數之成份股。詳細資訊請查閱ASMPT網頁www.asmpt.com。

前瞻性聲明

除歷史事實陳述外，本文所有陳述均是或可能是前瞻性聲明。這些前瞻性聲明反映 ASMPT 根據現時可得的資料所作出的假設，目前對未來的期望、信念、希望、意圖或策略。此等前瞻性聲明並非就未來的表現或事件作出保證，並涉及已知或未知的風險和不確定性。因此，多種因素可能導致實際結果與前瞻性聲明中包含的資料有重大差別。讀者不應過分依賴此等前瞻性聲明，而 ASMPT 不會承擔任何義務公開地更新或修訂任何前瞻性聲明。除下文另有提及外，本文中無任何陳述有意或可被解釋為盈利預測。

- 完 –

新聞垂詢:
林詒源 (Lim Ee Guan)
企業傳訊總監
電話：+65 6450 1445
電郵：eg.lim@asmpt.com

代表 ASMPT:
縱橫財經公關顧問有限公司
吳燕霞 / 梁頌欣
電話：+852 2864 4812 / 2864 4862
傳真：+852 2527 1196
電郵：mandy.go@sprg.com.hk / vivienne.leung@sprg.com.hk